

5G対応、高機能化、高密度化、薄肉化など様々な特性が求められているFPC  
FPCについて市場動向から基本的な製造方法や材料／製造技術の最新動向を解説！



# [次世代]FPC(フレキシブル配線板)の市場・業界動向、 及び材料技術、製造・開発技術動向 【Webセミナー対応】



日時	2020年7月13日(月) 10:30~16:30	会場	東京・品川区大井町 きゅりあん 5F 第4講習室
受講料	49,500円 ⇒S&T会員 46,970円 ※S&T会員(郵送DM案内あるいはE-mail案内を希望される方)は価格が5%OFFになります。 (定価:本体45,000円+税4,500円 会員:本体42,700円+税4,270円)		資料・昼食付

講師 株式会社PCテクノロジーサポート 代表取締役 柏木 修二 氏 (元住友電工プリントサーキット(株) 取締役技術部長)

**趣旨** スマートフォンに代表されるモバイル機器は、高性能・高機能化と同時に、軽量・薄型化を求められている。その為にデバイス・電子部品の高機能・小型・薄肉化やプリント配線板の薄肉・高機能・高密度配線化への要求がますます高まっている。特にFPCは、単なる配線材料としてだけでなく、デバイスやセンサー等、高機能部品のモジュール基板として多用され、軽量・薄型化や組み立てコスト低減に、ますますその重要性が高まっている。

今回のセミナーでは、FPCの市場動向や業界動向を解説した後、現状のFPC材料技術と製造技術、及び技術開発の動向について述べる。また今後の新しい市場として期待が高まっている5G対応高速伝送FPCや車載用途向けを中心に、次世代高機能FPCの技術開発動向と課題についても解説する。最後に弊社が継続的に実施している、最新のモバイル機器の分解調査から得られた知見に基づき、今後のFPCに関連する技術動向や需要動向を予測する。

<b>プログラム</b>	<b>1. FPCの市場動向</b> (1)FPC市場の変遷 (2)FPCの生産額の推移 (3)FPCの用途別シェアと用途別採用例	(3)FCCLの種類と特徴 (4)カバレイの種類と特徴 (5)シールド材の種類と特徴 (6)補強板の種類と特徴 (7)接着剤の種類と特徴	(2)高密度配線(ファイン回路・多層)FPC (3)車載向けFPC
	<b>2. FPCの業界動向</b> (1)FPCメーカー別グローバルシェア (2)FPCメーカーの売上額と損益の推移 (3)FPCメーカーの生産拠点 (4)FPCメーカーを中心としたサプライチェーン (5)主要FPCメーカーの概況 (6)主なリジッドフレキメーカー	<b>4. FPCの製造技術動向</b> (1)FPCの各製造工程の役割と生産技術動向 (2)片面・両面FPCの製造プロセス (3)多層FPCの製造プロセス (4)リジッドフレキの製造プロセス (5)FPCへの部品実装	<b>6. モバイル製品の分解調査と今後のFPCの需要・技術動向</b> (1)スマートフォンの生産予測 (2)iPhoneの分解とFPC・リジッドフレキ動向 (3)Galaxyの分解とFPC・リジッドフレキ動向 (4)Huaweiスマートフォンの分解とFPC動向 (5)その他中国スマートフォンの分解とFPC動向 (6)ディスプレイモジュール向けFPCの需要・技術動向 (7)カメラモジュール向けFPCの需要・技術動向 (8)ドック(USB)FPCの需要・技術動向
	<b>3. FPCの構成材料と技術動向</b> (1)FPCとリジッドフレキの基本構造と材料構成 (2)FPCの絶縁材料と銅箔の特徴	<b>5. 次世代FPCの技術開発動向</b> (1)5G向け高速伝送FPC	<b>7. まとめ</b> <input type="checkbox"/> 質疑応答・名刺交換 <input type="checkbox"/>

【テレワーク応援キャンペーン(1名受講)】【Live配信/WEBセミナー受講限定】 1名申込みの場合: 受講料(定価:35,200円/S&T会員 33,440円)  
・このセミナーは【会場での受講】の他に、【WEBセミナー(撮影した動画)】でのご受講が可能です。詳細はホームページをご確認ください。

■2名同時申込みで1名分無料■  
(1名あたり定価半額の24,750円)

※2名様ともS&T会員登録をしていただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。  
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。  
※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。  
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。  
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

<b>セミナー申込用紙</b> B200753 (FPC)			
会社名 団体名		住所	〒
部署			
役職			
ふりがな			
氏名			
TEL		FAX	
E-mail	※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。		
<p>●受講料について 「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。 ●お申込みについて 申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。 また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。 お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。 ●お支払いについて 受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、もしくは当日現金にてお支払いください。 銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。 振込手数料はお客様がご負担ください。</p>		<p>●個人情報の取り扱いについて ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。 詳しくはホームページをご覧ください。 ●キャンセル規定 開催日から逆算(営業日:土日・祝祭日等を除く)いたしまして、 ・開催7日前以前のキャンセル: キャンセル料はいただきません。 ・開催3~6日前でのキャンセル: 受講料の70% ・開催当日~2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100% ※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になる場合がございます。</p>	
<p>※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。 ※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。</p>		<p><b>今後のご案内</b> <input type="checkbox"/> E-mail希望・登録済み ) S&amp;T会員価格を <input type="checkbox"/> 郵送希望・登録済み ) 適用いたします。 <input type="checkbox"/> 希望しない ) (E-mailアドレス必須)</p> <p><b>お支払方法</b> <input type="checkbox"/> 銀行振込 (振込予定日 月 日) <input type="checkbox"/> 当日現金払い</p> <p><b>通信欄</b></p>	
<p>サイエンス &amp; テクノロジー 研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍 サイエンス&amp;テクノロジー株式会社 TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187 〒105-0013 東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F http://www.science-t.com</p>			

FAX 03-5733-4187

HPからも  
お申込みができます

検索  
サイトで

B200753 FPC

で検索!